

企業、業界、M&A、開示資料、ニュース、レポート、IR・統計、トレンド、特許、FLASH Opinionを検索

チケット残数  
5.00枚

業界を探す

業界概要

プレイヤー一覧

プレイヤー散布図

スタートアップ

ニュース

M&A

統計

IRデータ

レポート

業界指数

半導体（ロジック）業界 世界

ダウンロード

世界

JPN

CHN

TWN

USA

調査担当：Uzabase/ハイテク・資本財セクターチーム 最終更新日：2024年10月08日（最終訂正日：2024年10月08日）グラフは自動更新されます

業界基本情報

業界定義	リニア、ロジックIC等、「演算」することを目的とした半導体を製造する企業群。ICカード用のチップは本業界から除き、ICチップ・カード業界に含む
関連業界	半導体（メモリ）、半導体（ディスクリット）、半導体（パワー）、半導体（ファブレス）、半導体テスト・後工程受託、半導体ウエハ
関連トレンド	5Gにおける電子部品・素材、量子コンピューター
関連業界団体等	半導体産業研究所、日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)、電子情報技術産業協会 (JEITA)、Korea Semiconductor Industry Association (KSIA)

メニューを閉じる

最新M&A案件 [全ての業界M&A案件情報を見る](#)

 Foreign investors acquire stake in Taiwan Semiconductor Manufacturing	少数持分取得 - 取得価格 27,389 百万円	公表 - 2025/06/09
 Foreign investors sell stake in United Microelectronics	少数持分取得 - 取得価格 2,063 百万円	公表 - 2025/06/09
 Foreign investors acquire stake in Taiwan Semiconductor Manufacturing	少数持分取得 - 取得価格 4,806 百万円	公表 - 2025/06/06
 Foreign investors sell stake in United Microelectronics	少数持分取得 - 取得価格 1,936 百万円	公表 - 2025/06/06
 Foreign investors acquire stake in Taiwan Semiconductor Manufacturing	少数持分取得 - 取得価格 46,313 百万円	公表 - 2025/06/05

最新ニュース [全ての業界ニュースを見る](#)

半導体: 製造受託に懸けるインテル 顧客第一主義への転換図る＝服部毅

T SMCと東大が共同ラボ

米国株式ランキング：オラクルが13%超上昇／米国市場時間外コメント  
2025/06/13 06:54:34

©TSMCインパクト＝県立大に「半導体学部」 専門人材育成、2027年春めざす 菊陽町周辺に施設、視野

A r F／K r Fレジスト、中国勢の参入相次ぐ

レポートサマリー

業界概要

- ・ ICの複雑性とコストの高さから、ウエハ製造に特化したファウンドリ型モデルが増加
- ・ 世界のIC売上高はロジック分野が大半を占める
- ・ 2つのビジネスモデル：垂直統合型とファウンドリ
- ・ 微細化とスループットが生産性の鍵、先進パッケージング技術への関心が高まる
- ・ 資本集約的な業界、先端技術ノードでは前工程設備とフォトリソへの投資が必須

市場環境

- ・ 業界売上高は2023年に電子機器業界からの需要減により減少、2024-25年に回復見通し
- ・ 韓国・台湾を筆頭にアジア太平洋がファウンドリのウエハ生産能力革新で優位に
- ・ 米国の輸出規制に対抗すべく、中国は国内の半導体業界への投資を強化

競争環境

- ・ TSMCが売上高でリード
- ・ Samsung Electronics：ウエハ技術と先進パッケージング素材に長期的に注力する垂直統合型／ファウンドリ企業
- ・ Intel：最先端のウエハ技術とパッケージングソリューションに注力する垂直統合型企業
- ・ Taiwan Semiconductor Manufacturing：最先端のウエハ技術と、長期的に先進パッケージング材料に注力する専業ファウンドリ

## 業界概要

### ICの複雑性とコストの高さから、ウエハ製造に特化したファウンドリ型モデルが増加

半導体とは、電気を通す「導体」と電流を通さない「絶縁体」の中間的な性質を備えた物質である。世界の半導体市場データを提供する世界半導体貿易統計（WSTS）では、半導体を、ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサ、集積回路（IC）の4種類に分類している。さらに、ICを、マイクロIC、ロジックIC、アナログIC、メモリICの4種類に分類している。本レポートで主に取り上げるマイクロIC、ロジックIC、アナログICは、各種データの計算や演算を目的としているのに対し、メモリICはデータの記録や検索を目的とする（メモリ製品の詳細は[半導体（メモリ）](#)業界を参照）。

半導体製造に携わる企業のビジネスモデルは、垂直統合型デバイス製造（IDM）とファウンドリ（受託半導体製造）に大別される。垂直統合型では、チップの設計・製造を自社で一貫して行うが、ファウンドリは、ファブレス企業や垂直統合型企業が設計したチップの委託製造を行う。半導体業界では、IC製品の複雑性と設備投資の増加により、1社ですべての半導体製造プロセスをまかなうことがコスト面で難しくなりつつあることから、ファウンドリ型ビジネスモデルが重要性を増している。

### 世界のIC売上高はロジック分野が大半を占める

WSTSによると、世界のIC売上高は2023年に4,280億ドルとなった。うち、ロジック分野（ロジックIC、マイクロIC、アナログIC）が約78%と最も高いシェアを占め（2010年は約72%）、残りはメモリ分野が占めた。メモリを除くIC分野では、同年ロジックICが売上高の53%と最大シェアを占め（2010年は43%）、これにマイクロICが23%で続いた（2010年は34%）。

ロジックICは、基本的な論理演算を行うICである。マイクロICは、

台湾に代表されるアジア太平洋地域は、ファウンドリ型ビジネスモデルにおいてウエハ製造の開発でリードしている。主要企業は、ムーアの法則の限界が見えつつある中、コストを最小限に抑え、性能を向上させる先進パッケージング技術などの技術に注力している。

Boston Consulting Group（BCG）および米国の業界団体である米半導体工業会（SIA）によると、エンドユーザー市場別では、PC、ICTインフラ（データセンター、通信ネットワーク）、家電製品向けがロジック分野の売上高の多くを占めている。

MPU（マイクロプロセッサ）やMCU（マイクロコントローラユニット）など、コンピューターの中央演算処理装置の機能を1つのチップに集積した演算・論理処理機能を持つICを指す。マイクロICは、MPUの形態でモバイル機器に使用されている。また、アナログICはアナログ信号を処理するICである。

主な半導体製品の分類

		定義	製品	エンドユーザー
集積回路 (IC)	ロジック	論理回路を搭載した集積回路	・PLD（プログラマブルロジックデバイス） ・FPGA（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）	コンピューター
	マイクロ	半導体チップ上の演算システム集積回路	・マイクロプロセッサ（MPU） ・マイクロコントローラユニット（MCU） ・デジタル信号プロセッサ（DSP）	・コンピューター ・携帯電話
	アナログ	アナログ信号の処理を目的とする集積回路	・オペレーショナルアンプ ・コンバータ	・オーディオ／ビデオ機器 ・オフィス自動化
	メモリ	各種情報の記憶を目的とした集積回路	ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）	・コンピューター ・携帯電話
オプトエレクトロニクス		光センシング・光学発光装置	・光スイッチ ・ランプ	・カメラ ・医療機器
ディスクリート		単一機能のみ保有する素子	・ダイオード ・トランジスタ	家電製品
センサ		温度、圧力等との関連付けを目的とする半導体装置	温度センサ	・自動車 ・医療機器

出所：WSTSを基にUzabase作成

## 2つのビジネスモデル：垂直統合型とファウンドリ

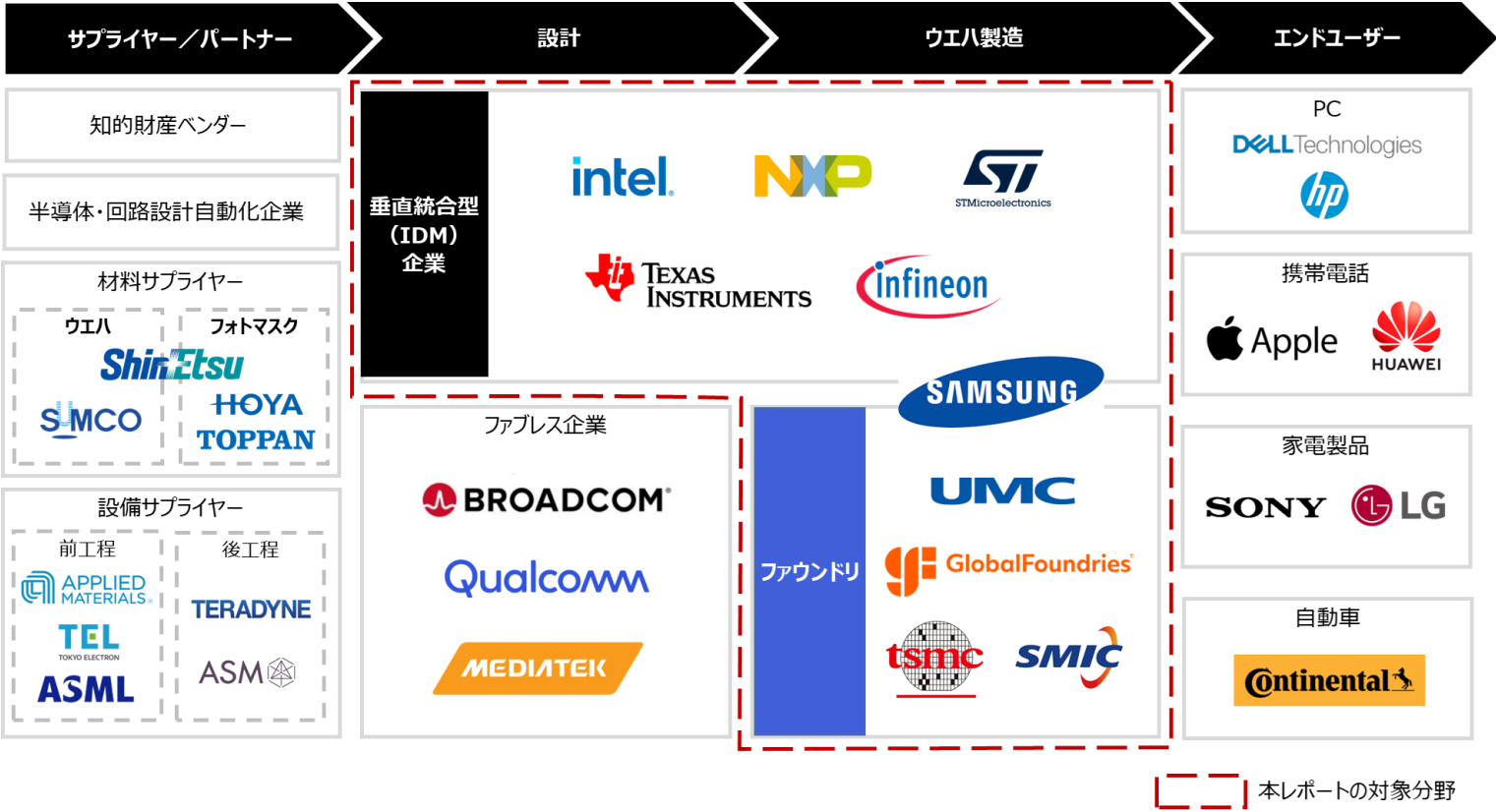
IC（ロジックICおよびメモリIC）は半導体製造工場で製造される。半導体製造工程は、1) 設計（半導体設計に携わる企業の詳細は[半導体（ファブレス）](#)業界を参照）、2) 前工程（ウエハ製造とも呼ばれる。詳細は[半導体・液晶製造装置（前工程）](#)業界を参照）、3) 後工程（組立・検査を行う。詳細は[半導体・液晶製造装置（後工程）](#)業界を参照）から成る。

ウエハの製造に携わる企業は、垂直統合型（垂直統合型デバイス製造）かファウンドリのどちらかに分類される。[Intel](#)（USA）や[Texas Instruments](#)（USA）などの垂直統合型企业は、チップの設計や製造を自社で行う。また、[Taiwan Semiconductor Manufacturing](#)（TWN、TSMC）、[United Microelectronics](#)（TWN）などのファウンドリは、ファブレス企業、ときには垂直統合型企业から提供される設計に基づき、オーダーメイドでチップを製造することを専門とする。

垂直統合型は、ICが現在ほど複雑でなかった初期の半導体業界で主流となったモデルである。しかし、研究開発・設備投資の拡大に伴い製品が複雑化すると、規模と専門性の両方が求められるようになり、ファブレス・ファウンドリモデルが登場した。

チップメーカーの多くは、エンドユーザーに応じ、特定タイプのロジックICに特化している。たとえば、[Intel](#)は、主にPC業界や携帯電話向けのマイクロプロセッサを生産している。マイクロプロセッサは、他の半導体製品に比べ技術的に高度で、製造が難しく価格も高い。一方、[Texas Instruments](#)は、産業用や自動車用のアンプやコンバータなどのアナログ製品を得意としている。

## 業界のバリューチェーン



出所：Uzabase作成

### 微細化とスループットが生産性の鍵、先進パッケージング技術への関心が高まる

ムーアの法則とは、1つのチップ上のトランジスタ数が2年ごとに2倍になるという経験則である。この法則は過去60年にわたり半導体業界の躍進を支える原動力でありつづけ、チップサイズの小型化のため

今後は製品サイズが5nm以下と、さらに縮小することが予想されているが、微細化のプロセスは減速しつつある。微細化は依然として本業界の主要な原動力ではあるもの、主要企業はコスト削減と性能向上

回路設計を精緻化する「微細化」が進んだ。微細化により、1枚のシリコンウエハから切り出せるICチップの数が増え、コスト削減につながる。トランジスタのサイズは、ナノメートル（nm）で呼称されるプロセスノードで測られる。たとえば、[Intel](#)は2025年までに1.8nm製品、[Samsung Electronics](#)（KOR）は2027年までに1.4nm製品の生産を目指している。

一方、スループット歩留まり（throughput yield）により、総生産量における欠陥のないユニットの生産能力が測定できる。メーカーは、先進的なツールや機器への投資など様々な戦略で歩留まりの改善を図っている。一般的に、スループット歩留まりは、新製品の製造開始時や新製品技術の導入時に低下する傾向にある。

資本集約的な業界、先端技術ノードでは前工程設備とフォトマスクへの投資が必須

ウエハ製造は資本集約的な工程である。米国議会の公共政策研究機関である議会調査局（CRS）によると、半導体製造工場の新規建設には70億ドル近く、最先端レベルの工場の場合では200億ドルもの費用がかかるという。

またSIAによると、ウエハ製造の資本集約的な性質は、その規模や、前工程製造装置などの複雑な設備が必要なことに起因する。前工程製造装置とは、半導体を出来る限り強固かつ小型化するリソグラフィ技術やフォトマスクを中心とする装置である（前工程製造装置の詳細は[半導体製造装置-前工程](#)業界、[フォトマスク](#)業界を参照）。また本業界では、微細化された先端チップの開発に伴って研究開発費の増加がみられるが、垂直統合型企業は半導体の設計も行うため、売上高に対する研究開発費比率が高い傾向にある。

の面で優位に立つため、先進パッケージングなどの技術へも投資している。

パッケージングは、半導体開発の最終工程で、シリコンウエハをサポートケースに包み、物理的な損傷や腐食から保護し、またチップを回路基板に接続する役割を果たす。2.5D、3D、ファンアウト、システムオンチップ（SoC）などの先進パッケージング技術により、従来のパッケージング技術よりも優れた接続性と省電力性が実現する。2020年には、[TSMC](#)が、複数のシリコンダイを2.5／3Dに集積化する包括的な先進パッケージング技術「3DFabric」を導入した。

年間売上高に対するコスト構造（2018-23年平均）

ビジネスモデル	研究開発	粗利益率	営業利益率
垂直統合型			
<a href="#">Intel</a>	22%	52%	21%
<a href="#">NXP Semiconductors</a> (NLD)	18%	54%	16%
ファウンドリ			
<a href="#">TSMC</a>	8%	52%	41%
<a href="#">United Microelectronics</a> (TWN)	7%	28%	18%

出所：各社公表資料を基にUzabase作成

市場環境

業界売上高は2023年に電子機器業界からの需要減により減少、2024-

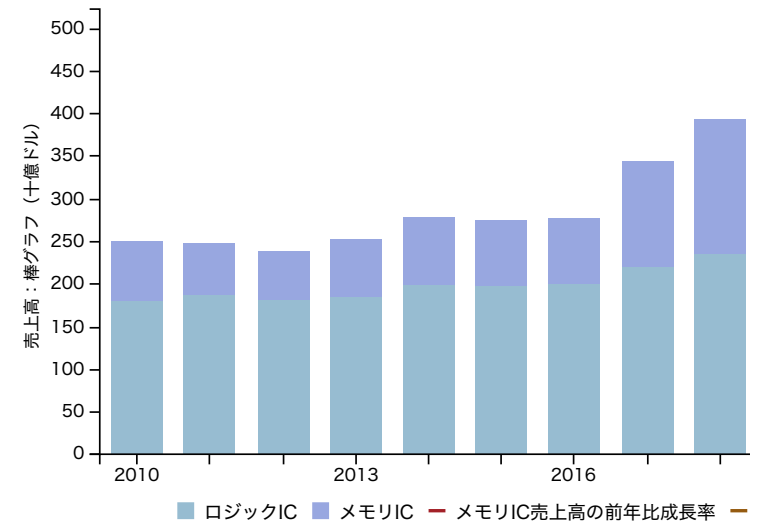
## 25年に回復見通し

ロジックIC売上高は2013-23年にかけて、家電業界からの需要増にけん引され平均年間成長率6%で成長した。ただ、成長率はメモリ分野（同8%）と比べるとやや緩やかなペースといえる。メモリ分野の成長率が高い背景には、IoT機器（エンドユーザーアプリケーションに、エッジハードウェア、アクセスポイント、データネットワークを接続するソフトウェア）の登場があり、その需要を満たすためにデータ／サーバーセンターからメモリ関連機器の需要が増加した。一方で、特定の製品で安定しているロジック市場と比べ、メモリ市場は汎用的な製品構成であるため変動が大きい傾向があるといえる。

2012年、2013年、2015年、2016年はドル高現地通貨安に起因した個人消費の低迷によりロジックIC売上高は不振した。たとえば欧州では、部品の多くがドル建てで販売されていたことから、現地通貨での携帯電話の販売価格が上昇した。その結果、消費者は購入を先延ばしにするか、より安価な代替品の購入かを選択することとなり半導体の売上が減少した。2019年の売上高は前年比4%減となった。この理由としては、米中貿易摩擦を背景に半導体市場では市場心理の悪化や、世界のスマートフォン販売台数の減少（前年比2%減、成熟した市場でのハイエンド製品分野における供給過剰、買い替えサイクルの長期化などに起因）が挙げられる。

続く2020年はコロナ禍の影響による経済の混乱にもかかわらず、前年比7%の成長を遂げた。これは、「巣ごもり」需要の影響により、PC・タブレットの買い替えが増加したことによる。2021年には、需要の伸びと原材料価格の高騰により半導体の平均販売価格が押し上げられ、前年比27%で成長はさらに加速した。2022年は前年の伸び率には届かなかったものの、前年比約11%増となった。主に自動車業界と産業からの需要の伸びがこの成長を下支えした。ただ、2023年には最終市場である電子機器需要が軟化し業界成長が鈍化したことから、ロジックICの売上高は前年度比約2%減少した。WSTSによると、世界のロジックICの売上高は2024-25年にかけてCAGR約7%で増加すると予測される。

ロジックICとメモリICの売上高推移



出所：WSTS



韓国・台湾を筆頭にアジア太平洋がファウンドリのウエハ生産能力革新で優位に

市場調査会社IC Insightsによると、2021年12月時点（入手可能な最新データ）の世界の月間ウエハ生産能力（200mm換算）は、韓国が23%と最大シェアを占めトップ、これに台湾（21%）が僅差で続いた。同時点で、台湾、韓国、日本、中国のアジア太平洋4か国を合わせると、世界のウエハ生産能力の75%を占める。

BCGとSIAによると、米国にある工場の総所有コストは、政府の優遇措置のあるアジアと比較すると25~50%ほど高い。特に台湾当局は直接的な支援を実施しており、研究開発用の研究所や工業団地の設置、機器購入時の税制優遇措置、そして資金提供などの間接的な優遇措置なども行っている。

韓国や台湾の企業はチップ製造を専門とするファウンドリモデルのパイオニアでもある。IC Insightsによると、台湾には本業界の2大専門ファウンドリであるTSMCとUMCがあり、2020年12月時点で、世界の月間ウエハ生産能力（200mm換算）の16%を占めている（入手可能な最新データ）。

月間ウエハ生産能力（200mm換算）

国・地域	2015年12月時点の月間ウエハ生産能力 （百万枚）	世界シェア	2018年12月時点の月間ウエハ生産能力 （百万枚）	世界シェア	2021年12月時点の月間ウエハ生産能力 （百万枚）	世界シェア
台湾	3.5	22%	4.1	22%	4.5	21%
韓国	3.4	21%	4.0	21%	5.0	23%
日本	2.8	17%	3.2	17%	3.2	15%
米州	2.3	14%	2.4	13%	2.4	11%
中国	1.6	10%	2.4	13%	3.5	16%
欧州	1.0	6%	1.1	6%	1.1	5%
その他	1.7	10%	1.6	9%	1.9	9%
合計	16.4		18.9		21.6	

出所：Knometa Researchおよび各種記事を基にUzabase作成  
注1：数値は四捨五入しているため合計100%にならない場合がある  
注2：2021年が入手可能な最新データ

米国の輸出規制に対抗すべく、中国は国内の半導体業界への投資を強化

BCGとSIAによると、電子機器製造の主要なハブである中国は、2019年に世界チップ売上高（デバイスが製造または組み立てられた場所に基づく）の約35%を占める最大の製造元であり、これに米国（19%）が続いた（入手可能な最新データ）。Knometa Researchによると、2021年12月時点の月間ウエハ生産能力（200mm換算）において、中国は世界の16%を占め、2015年12月時点のわずか10%から成長した。なお、米州の同生産能力シェアは11%（2015年12月は14%）であった。

世界の半導体サプライチェーンは高度に専門化されており、技術的なノウハウや規模の必要性から、地域ごとに役割が異なる。たとえば、米国は電子設計の自動化、チップ設計、高度な製造装置などの研究開発集約的な活動でリードしているのに対し、中国はより労働集約的な組立、パッケージング、テストでトップを占めている。このように、すべての国は相互依存の関係にあり、必要な拠点に設備や材料などを移送する際は自由貿易が適用されている。

中国が持つ最新のチップ製造技術力を懸念し、米国政府は2019年と2020年に、国家安全保障上のリスクがあるとして、Huaweiをはじめとする中国企業が、米国の技術を搭載した半導体へアクセスすることを制限する一連の輸出規制を課した。中国はその対抗策として、政府の支援によりチップ製造への国内投資を増やしている。「中国製造2025」計画では、2025年までに半導体の国内需要のうち70%を国内で生産することを目標としているが、米国の規制がもたらす課題や現在の生産能力（2021年は17%）を考えると、極めて楽観的といえる（入手可能な最新データ）。

競争環境

### TSMCが売上高でリード

半導体業界の企業形態には、垂直統合型とファウンドリがある。ウエハ生産能力と売上高では、**TSMC**が売上高で首位、双方のビジネスモデルを組み合わせた**Samsung Electronics**が生産能力で首位となっている。

各企業は、異なるエンドユーザー分野向けに特定の製品を提供している。たとえば、**Intel**は主にPCや携帯電話向けのマイクロプロセッサに、**Texas Instruments**は産業用や自動車用のアンプやコンバータなどのアナログ製品に特化している。

主要な半導体企業（ロジックIC、2023年）

企業	国・地域	ビジネスモデル	売上高（億ドル）*	月間ウエハ生産能力（2021年12月時点における月間ウエハ生産能力（200mm換算）、百万枚／月）	ロジックIC	マイクロIC	アナログIC	エンドユーザー市場
<b>Samsung</b>	韓国	垂直統合型／	510**	4.1	×	○	×	PC、モバイル

Electronics		ファウンドリ						機器
TSMC	台湾	ファウンドリ	690	2.8	○	○	○	モバイル機器、PC、家電製品
Intel	米国	垂直統合型	540	入手不可	○	○	×	PC
Texas Instruments	米国	垂直統合型	160**	入手不可	×	×	○	産業用・自動車用製品、家電製品
NXP Semiconductors	オランダ	垂直統合型	130	入手不可	×	○	○	産業用・自動車用製品、携帯電話、通信
United Microelectronics	台湾	ファウンドリ	70	入手不可	○	○	×	携帯電話、PC

出所：公表資料を基にUzabase作成

注1：\*売上高および生産能力についてはロジックIC・メモリIC分野の合計値

注2：\*\*Samsung ElectronicsおよびTexas Instrumentsの売上高は半導体部門のみを対象

Samsung Electronics：ウエハ技術と先進パッケージング素材に長期的に注力する垂直統合型／ファウンドリ企業

Samsung Electronicsは、それぞれが独立して運営される4つの事業部門から構成される。1) テレビ、モニター、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等を製造・販売するDX（Device Experience）事業、2) メモリ製品、論理処理、ファウンドリ、ディスプレイ製品等を製造・販売するDS（Device Solutions）事業、3) スマートフォン向けOLEDパネルを製造・販売するSDC（Samsung Display and Subsidiaries）事業、4) デジタルコックピット、テレマティクス、スピーカー等を製造するHarman事業がある。

同社は、垂直統合型企业であるだけでなく、ファウンドリ事業として他社向けのカスタマイズ半導体を製造しており、TSMCと競合する。製造工場は、米国・テキサス州と中国・西安市にある。同社は、論理処理事業における中長期戦略の中で、5Gやスマートモビリティなどの革新的な半導体技術の追求を継続するとしている。同時に、ファウンドリ事業では、最先端技術を維持し（2027年までに1.4nm生

DS事業の売上高（2023年度総売上高の26%）は、2012-21年度にかけて増加傾向を示した。なかでも、2017年度には前年度比約49%増と大幅成長を遂げた。この成長は主にメモリ事業にけん引されたもので、2016年第4四半期に10nmのDRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）製品を発売している。同社はその後もさらに開発を進め、同製品は2018年度売上高の二桁成長を支えた。ただ、2019年度は市場での供給過剰を受けメモリ価格が低迷したため、売上高は前年度比約29%減少した。2022年度は韓国ウォンベースでは増加したものの、ドルベースでは為替変動の影響（2022年度）と需要低迷ならびに製品価格の下落（2023年度）を受け、2021-23年度にかけてCAGR約-21%で減少した。

営業利益率は、2019年度の減収に伴う大幅な低下（前年度比30ポイント減）を除いて、2012-21年度にかけて上昇傾向を示した。だが2022年度は、前年度比7ポイント低下した。続く2023年度は損失を計

産）、先進パッケージングソリューションなどの差別化した製品の拡大を見込んでいる。

上した。

#### Intel：最先端のウエハ技術とパッケージングソリューションに注力する垂直統合型企業

Intelは、世界のPCおよびデータを中心に据えた（データセントリック）市場向けのマイクロプロセッサおよびプラットフォームソリューションを設計・製造する大手垂直統合型企業である。ロジックウエハ製造のほとんどは、米国内で行われている。2023年時点で世界に9の製造拠点を所有しており、内訳はウエハ製造工場5か所（オレゴン州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、アイルランド、イスラエル）、組立／テスト施設4か所（中国・成都、マレーシア、ベトナム、コスタリカ）となっている。

同社の3大顧客であるDell（USA）、Lenovo（HKG）、HP（USA）の3社は、2023年度売上高の40%を占めた。2023年時度点で、クライアント・コンピューティング（PCを中心とするビジネス向けのプラットフォームを含む）は、総売上高の5割近くを占め、次いでデータセンター（29%、クラウドサービス・プロバイダーなどのデータセントリックビジネス向けのプラットフォームおよびその他関連製品）が続いた。顧客の所在地別では、同年度、中国（総売上高の27%）が最大で、次いで米国（同26%）、シンガポール（同16%）となっている。

同社は、コンピューティングと通信に関連する技術の継続的な革新と、よりデータセントリックな組織になることを目指す。2025年までに1.8nm製品の生産を目指しており、先進パッケージング技術にも投資している。

売上高は2012-21年度にかけてデータけん引型事業の成長を受け増加傾向を示したのち、2021-23年度にかけてはクラウドコンピューティング部門とデータセンター部門からの需要が落ち込んだためCAGR約-17%で減少した。営業利益率は、2012-23年度にかけて変動的に推移し、2013年度は前年度比4ポイント減、2014-16年度は3ポイント減、2018-23年度は33ポイント減となった。2016年度の営業利益率の低下は、FPGA（Field-Programmable Gate Array）メーカーのAltera（USA）の買収関連費用の償却によるところが大きい。FPGAは、現場でプログラムが可能なICで、要望のアプリケーションに応じてカスタマイズ可能なプログラマブル・ロジック・ブロックを備えるICである。2020年度は、売上高成長にもかかわらず、10nmプロセス技術に関連したプラットフォーム分野におけるコスト増加により営業利益率が低下した。2021年度も、研究開発費を主とした営業費用がかさみ低下した。

#### Taiwan Semiconductor Manufacturing：最先端のウエハ技術と、長期的に先進パッケージング材料に注力する専門ファウンドリ

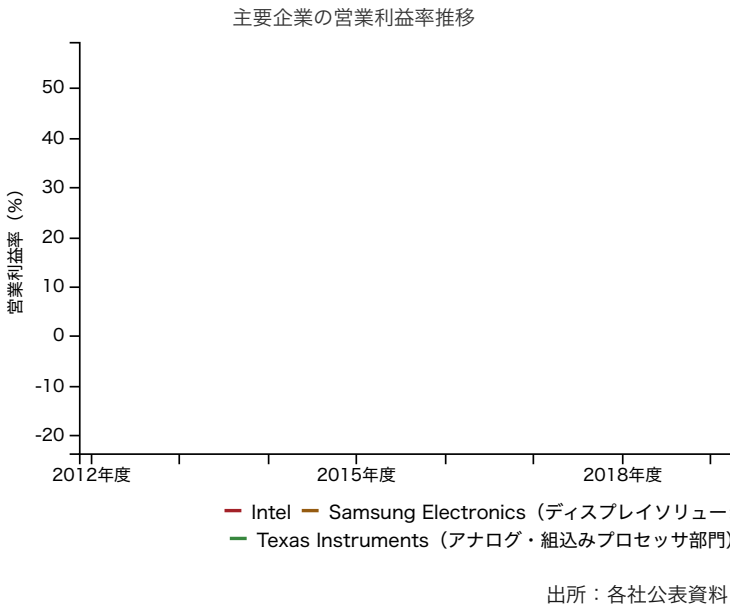
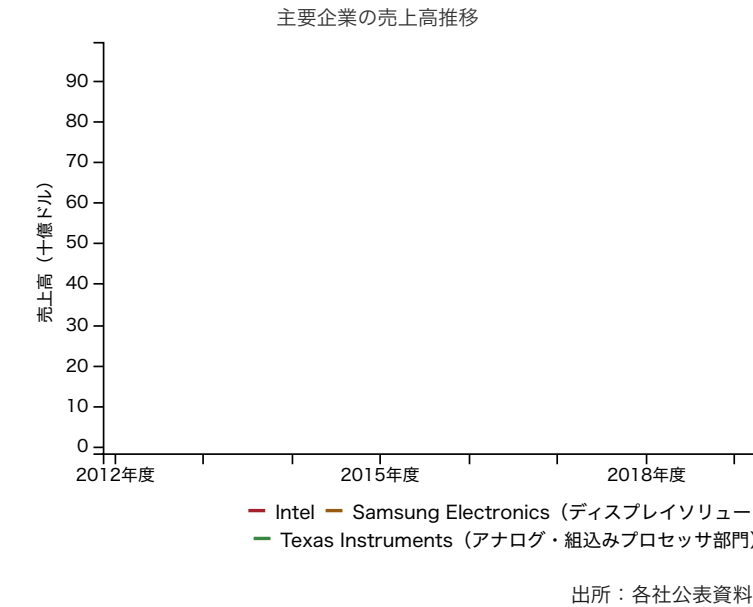
TSMCは、2023年時点で16インチ換算で1,200万枚を超えるウエハ製造設備を持つ世界最大のファウンドリである。台湾に9か所、中国に2か所、米国に1か所、合計で12の製造設備を運営する。さらに台湾では、3か所の後工程製造設備も有する。

同社は、短期的には、生産能力の継続的な向上と研究開発投資によ

2023年度売上高をみると、約43%がハイパフォーマンス・コンピューティング・プラットフォーム事業によるもので、これにスマートフォン事業（38%）、IoT事業（7%）が続く。顧客の所在地別にみると、売上高の約65%が米国、次いで中国（12%）、台湾（7%）となっている。

り、ファウンドリ事業における市場シェアの持続を目指す。長期的には、ムーアの法則（2025年までに2nm生産予定）に沿った最先端技術の開発を継続し、先進パッケージング技術やシリコン積層技術、検査サービスなど、より統合的なサービスの提供に取り組むとしている。

売上高は2012-22年度にかけてCAGR16%で継続的に成長したのち、2023年度には前年度比約9%減少した。なお、2015年度と2019年度は、PC・家電製品市場が低調であったことを主因に前年度比5%以下の成長率となった。営業利益率は2012-23年度にかけて安定的に推移したが、2016-19年度にかけては研究開発費の増加を主因に5ポイント、2021年度は前年度比1ポイント、2023年度は同7ポイント低下している。





業界プレイヤー

全競合企業を見る

対象企業

アナリストによる業界選定のみを表示

(単位：百万円)	決算期	売上高 合計	親会社株 主に帰属す る当期純利 益	親会社株 主に帰属す る当期純利 益率	売上高増 加率	期末従業 員数	時価総額	PER	企業価 値/ EBITDA
 Samsung Electronics Co Ltd	2024/12	33,490,738	3,742,483	11.2 %	16.2 %	129,480 人	42,183,291	11.7 倍	4.1 倍
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,	2024/12	13,669,455	5,470,886	40.0 %	33.9 %	83,825 人	130,355,555	23.4 倍	12.9 倍
 ソニーグループ	2025/03	12,957,064	1,141,600	8.8 %	-0.5 %	N/A	22,969,543	19.7 倍	9.2 倍
 Intel Corp	2024/12	8,055,001	-2,845,137	-35.3 %	-2.1 %	108,900 人	14,330,909	N/A	-206.5 倍
 Texas Instruments Inc	2024/12	2,372,616	724,330	30.5 %	-10.7 %	34,000 人	28,691,564	38.0 倍	24.9 倍
 STMicroelectronics NV	2024/12	2,012,802	236,185	11.7 %	-23.2 %	49,602 人	4,210,925	17.1 倍	7.0 倍
 NXP Semiconductors NV	2024/12	1,913,444	380,747	19.9 %	-5.0 %	33,100 人	8,687,480	21.9 倍	14.8 倍
 Analog Devices Inc	2024/10	1,419,235	246,186	17.3 %	-23.4 %	24,000 人	17,697,658	70.4 倍	29.2 倍
 ルネサスエレクトロニクス	2024/12	1,348,479	219,084	16.2 %	-8.2 %	22,711 人	3,574,745	15.7 倍	10.7 倍
 Semiconductor Manufacturing International Corp	2024/12	1,218,075	74,746	6.1 %	27.0 %	19,186 人	8,528,236	109.4 倍	17.2 倍
 United Microelectronics Corp.	2024/12	1,097,136	230,379	21.0 %	4.4 %	19,016 人	2,856,913	12.2 倍	5.3 倍
 ON Semiconductor Corp	2024/12	1,074,329	238,581	22.2 %	-14.2 %	26,490 人	3,502,036	14.1 倍	9.3 倍
 GLOBALFOUNDRIES Inc	2024/12	1,023,922	-40,198	-3.9 %	-8.7 %	13,000 人	3,325,640	N/A	15.3 倍
 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（非上場）	2024/03	1,014,112	-4,795	-0.5 %	24.9 %	N/A	N/A	N/A	N/A

	2023/12	765,333	107,133	14.0 %	0.1 %	N/A	N/A	N/A	N/A
業界平均	N/A	1,279,317	140,814	6.5 %	-1.5 %	24,085 人	10,088,552	38.1 倍	0.2 倍

- ・ 上記数値は直近株価（直近営業日終値）及び実績値は直近本決算数値を、予想値は会社発表の当期予想を基に計算しております。
- ・ 競合企業は売上高合計順に最大15社まで表示しております。
- ・ デフォルト表示する比較企業の地域（日本企業のみ表示等）は [こちら](#) から変更できます。
- ・ 業界平均の計算はアナリストにより業界選定された企業のみにより計算されております。